

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2022-046

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于拟发行债权融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为了进一步拓宽上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化融资结构，补充公司经营所需流动资金，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”）。具体情况如下：

一、本次发行债权融资计划的具体方案

- 注册额度：不超过3亿元人民币（含3亿元）。
- 发行期限：不超过3年（含3年）。
- 发行利率：按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
- 募集资金用途：按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
- 担保安排：本次发行债权融资计划由本公司提供信用担保。
- 发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。
- 发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。
- 发行对象：北京金融资产交易所认定的合格投资者。
- 主承销商：招商银行股份有限公司。
- 决议有效期：自股东大会审议通过之日起，在本次发行的备案期内持续有效。

二、本次发行债权融资计划的授权事宜

为保证本次债权融资计划顺利发行，公司拟提请股东大会授权经营层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行相关事宜。

3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议程序

本次拟发行债权融资计划的事项已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。最终方案以北京金融资产交易所备案登记文件为准。

本事项尚需经北京金融资产交易所接受备案后方可实施。公司将根据有关法律、法规及本次申请发行债权融资计划的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、本次发行债权融资计划对公司的影响

本次债权融资计划事项是公司综合考虑资本运作战略、经营发展规划和资金需要做出的决定，有利于拓宽公司的融资渠道，优化融资结构，对公司的资金管理、经营运作起到积极的推动作用。目前，公司各项业务经营情况正常，本次发行债权融资计划不会对公司正常运营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司本次拟发行债权融资计划方案合理，切实可行，有利于拓宽公司融资渠

道，优化公司资本结构，符合公司发展需要。本次拟发行债权融资计划的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司向北京金融资产交易所申请备案发行不超过3亿元（含3亿元）的债权融资计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

本次公司拟发行债权融资计划有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，积极推动公司的资金管理和经营运作的灵活性，符合法律法规、《公司章程》及相关规则的规定，决策程序合法、有序，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司发行债权融资计划事项。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2022年4月23日